

入札公告

次のとおり一般競争入札に付します。

令和8年5月1日

国立大学法人東京大学総長 藤井 輝夫

◎調達機関番号 415 ◎所在地番号 13

○第7号

1 調達内容

(1) 品目分類番号 24

(2) 購入等件名及び数量

低コストチップ間インターフェース回路チップ試作 一式

(3) 調達件名の特質等 入札説明書による。

(4) 納入期限 令和9年3月19日

(5) 納入場所 東京大学大学院工学系研究科

(6) 入札方法 落札決定に当たっては、リバースオークションシステム（以下「システム」という。）に入力された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額をシステムに入力すること。

2 競争参加資格

(1) 国立大学法人東京大学の契約事務取扱規程第2条及び第3条の規定に該当しない者であること。

(2) 国の競争参加資格（全省庁統一資格）において令和8年度に関東・甲信越地域の「物品の製造又は物品の販売」のA、B又はC等級に格付けされている者であること。なお、当該競争参加資格については、令和8年3月31日付け号外政府調達第58号の官報の競争参加者の資格に関する公示の別表に掲げる申請受付窓口において随時受け付けている。

(3) 製造物品に関する研究体制及び迅速なアフターサービス・メンテナンスの体制が整備されていることを証明した者であること。

(4) 入札説明書で指定する内容等を満たす者であること。

(5) 総長から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。

3 入札書の提出場所等

(1) 書類（入札書を除く）の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先 〒113-8654 東京都文京区本郷7-3-1 東京大学本部契約課（本部棟2階） 酒泉 創 電話 03-5841-2148 東京大学ホームページ（大学案内>調達・契約

>調達情報>入札公告) <https://www.u-tokyo.ac.jp/ja/about/procurement-contracts/nyusatsu/index.php> を参照の上、本部契約課集中調達チームのメールアドレス宛に問い合わせること。なお、メールタイトルに調達件名を記載すること。

(2) 入札説明書の交付方法 本公告の日から東京大学ホームページ（大学案内>調達・契約>調達・契約について>リバースオークションについて）<https://www.u-tokyo.ac.jp/ja/about/procurement-contracts/reverse.html> において、電子ファイルにて交付する。

(3) 書類の受領期限 令和8年5月27日17時00分

(4) 入札、開札の日時及び場所 令和8年6月17日16時30分 電子入札（リバースオークション）

4 その他

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨。

(2) 入札保証金及び契約保証金 免除。

(3) 入札者に要求される事項 この一般競争に参加を希望する者は、本公告に示した物品を納入できることを証明する書類を3(3)の書類の受領期限までに提出しなければならない。入札者は、入札日の前日までの間において、総長から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。

(4) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者の入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者の入札、その他入札説明書による。

(5) 契約書作成の要否 要。

(6) 落札者の決定方法 本公告に示した物品を納入できると総長が判断した入札者であって、国立大学法人東京大学の契約事務取扱規程第11条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。

(7) 手続における交渉の有無 無。

(8) その他 詳細は、入札説明書による。なお、入札説明書等で当該調達に関する環境上の条件を定めた調達であると示されている場合は、十分理解した上で応札すること。

5 Summary

(1) Official in charge of disbursement of the procuring entity: FUJII Teruo, President of the University of Tokyo

(2) Classification of the products to be procured : 24

(3) Nature and quantity of the products to be manufactured : Chip Prototyping for Low-cost Die-to-Die Interface Circuits, 1 Set

(4) Delivery period : By 19 March, 2027

(5) Delivery place : Graduate School of Engineering, The University of Tokyo

(6) Qualifications for participating in the tendering procedures : Suppliers eligible for participating in the proposed tender are those who shall :

A not come under Article 2 and 3 of the Regulation concerning the Contract for The University of Tokyo,

B have the Grade A, Grade B or Grade C qualification during fiscal 2026 in the Kanto・Koshinetsu area in manufacture of product or sales of product for participating in tenders by Single qualification for every ministry and agency,

C prove to have prepared a system to provide research, rapid after-sale service and maintenance for the procured products,

D meet content specified in the tender documentation,

E not be currently under a suspension of business order as instructed by President of the University of Tokyo.

(7) Time limit of the documents : 17:00 27 May, 2026

(8) Contact point for the notice : SAKAIZUMI hajime, Contract Group, Finance Department, The University of Tokyo, 7-3-1 Hongo Bunkyo-Ku Tokyo 113-8654 Japan, TEL 03-5841-2148, URL: <https://www.u-tokyo.ac.jp/ja/about/procurement-contracts/nyusatsu/index.php>

(9) Please be noted that if it is indicated that environmental conditions relating to the procurement are laid down in its tender documents.